

2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年2月14日

上場会社名 ウインテスト株式会社 上場取引所 東
コード番号 6721 URL https://www.wintest.co.jp/
代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 姜 輝
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 鎌田 文明 TEL 045-317-7888
定時株主総会開催予定日 2025年3月27日 配当支払開始予定日 -
有価証券報告書提出予定日 2025年3月31日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年12月期の連結業績（2024年1月1日～2024年12月31日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期	417	2.4	△1,083	-	△1,094	-	△1,105	-
2023年12月期	407	93.7	△558	-	△552	-	△554	-

(注) 包括利益 2024年12月期 △1,069百万円 (-%) 2023年12月期 △520百万円 (-%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2024年12月期	△25.27	-	△94.6	△69.0	△259.9
2023年12月期	△13.85	-	△37.0	△28.5	△137.1

(参考) 持分法投資損益 2024年12月期 一百万円 2023年12月期 一百万円

(注) 2023年12月期及び2024年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年12月期	1,195	699	57.0	15.12
2023年12月期	1,973	1,665	83.9	37.94

(参考) 自己資本 2024年12月期 681百万円 2023年12月期 1,655百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2024年12月期	△662	△1	171	90
2023年12月期	△558	△0	641	361

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2023年12月期	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
2024年12月期	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
2025年12月期(予想)	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-

3. 2025年12月期の連結業績予想（2025年1月1日～2025年12月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通期	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2025年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。詳細については、添付資料P3「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更：無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無

② ①以外の会計方針の変更：無

③ 会計上の見積りの変更：有

④ 修正再表示：無

(注) 詳細は、添付資料P. 17「3. 連結財務諸表及び主な注記（5）連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変更）」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数

2024年12月期	45,059,100株	2023年12月期	43,641,000株
2024年12月期	－株	2023年12月期	－株
2024年12月期	43,761,441株	2023年12月期	40,029,819株

(参考) 個別業績の概要

2024年12月期の個別業績（2024年1月1日～2024年12月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年12月期	225	△21.3	△832	－	△840	－	△1,392	－
2023年12月期	286	21.4	△496	－	△498	－	△500	－

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2024年12月期	△31.81	－
2023年12月期	△12.50	－

(注) 2023年12月期及び2024年12月の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年12月期	999	696	67.9	15.04
2023年12月期	2,223	1,984	88.9	45.27

(参考) 自己資本 2024年12月期 677百万円 2023年12月期 1,975百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。

また上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。

決算補足説明資料は、当社のホームページ(<https://www.wintest.co.jp/>)に掲載します。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(6) 継続企業の前提に関する重要事象等	5
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	6
3. 連結財務諸表及び主な注記	7
(1) 連結貸借対照表	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	9
連結損益計算書	9
連結包括利益計算書	10
(3) 連結株主資本等変動計算書	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	14
(継続企業の前提に関する注記)	14
(会計方針の変更)	17
(会計上の見積りの変更)	17
(連結損益計算書に関する注記)	18
(セグメント情報等の注記)	19
(1株当たり情報)	21
(重要な後発事象)	22

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度(2024年1月～12月)における世界半導体市場は、WSTS(World Semiconductor Trade Statistics/世界半導体市場統計)の発表によると、前年比+16.0%増の6,112億ドル(約95兆円)になるとの見通しでした。AI関連投資が好調で、これに伴ってメモリ製品やAIで使用されるGPUなどの複合ロジック製品半導体が市場の牽引役となりました。一方AI関連を除くと、自動車用途が低迷したほか、設備投資の冷え込みを背景とした産業用途の不振、また民生向け半導体など全方位に亘り多くの製品で前年比マイナス成長となりました。2023年の半導体ダブつき解消後の「復活の年」という意味でも大きく期待された2024年の新規設備投資は、半導体工場各社の稼働率低迷継続をうけ、新規設備投資の抑制が年度末まで続く事態となりました(2025年1月6日付ストックマーク社記事「2024年の半導体市場は「復活の年」だったのか?」より引用)。そのため、当社グループの2024年度の受注、売上は低調に推移いたしました。

当社グループが属する半導体市場の2025年度は、WSTSによると市場規模は2024年比+12%増の6,873億ドルと、過去最高を更新し、2024年に引き続きAI関連の需要が伸びると予想されております。2024年度との違いは、低迷していたAI関連投資以外の分野も伸びるとされており、再生可能エネルギーの電源や電気自動車(EV)のほか、自動運転に使う半導体の需要も増えるとされています。また再生途中である日本の半導体市場も、2024年は前年比5%増の約6兆8,670億円の市場規模となると予想されおり、特に民生半導体工場など政府の補助金によって半導体投資が活発となり、2025年は+9%増の約7兆5,088億円の市場規模となる見通しであるとの発表もされております。

ディスプレイデバイス市場の調査を行ったPando社によると、表示デバイス市場は、2025年から2032年にかけて+12.9%のCAGR(年平均成長率)で成長すると予想されています。ディスプレイデバイス市場規模は、2027年までに1,900億ドルに達する見込であり、特にOLEDやMini-LED技術の普及がキードライバーとなり、スマートフォン、テレビ、業務用ディスプレイなどでの2024年に落ち込みがみられた民生品需要が、高まって来るものとされております。また、4K及び8K解像度への移行も進行中で、消費者及び企業向けの高性能製品へのニーズが強化されています。

今後もウインテストグループとして、横浜本社、大阪事業所における開発環境整備、人材育成及び増員に努め、組織の若返りを含めた強化を行い、総務経理部を含む各部署における業務推進体制を革新するため、ERPやITを駆使した、より機動的かつ最新の環境で、設計、開発及び経営能力を強化するとともに、トータルコストの削減、納期の短縮と品質の向上を目指し、顧客満足度を上げることで受注増、業績の向上、企業価値の増大を図り、株主様の利益につなげてまいります。

以上のように2025年以降のAI関連投資が見込まれるものの、2024年は新規設備投資の抑制を受け業績は低調に推移いたしました。

また、当社は、当社グループが保有する棚卸資産について厳格な評価を実施し、連結において574,470千円の棚卸資産評価損(売上原価)を計上いたしました。

近年、業界全体において市場環境が変化しており、特に受注の伸び悩みが見られる状況が続いています。当社におきましても、一部製品の市場動向を慎重に精査した結果、保有する棚卸資産の一部について、将来的な回収可能性について精度を高めて評価する必要があると判断しました。これに伴い、監査法人とも協議のうえ、適正な会計処理を行うために棚卸資産の評価損を計上することといたしました。

これは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)に従い資産評価の健全性を確保するために実施するものであります。今回の評価損計上により、短期的な財務指標には影響が出るものの、これは将来的な財務の健全性を確保し、持続的な成長基盤を強化するための戦略的な判断であります。当社は今後も、事業構造の見直しや市場ニーズに適した製品戦略を推進し、収益性の向上を図る施策を進めてまいります。また、当該棚卸資産に関しましては、2025年以降出荷される製品にすべて組み込む予定です。

以上より、当社の当連結会計年度の売上高は417,090千円となり、営業損失は1,083,829千円、経常損失は1,094,080千円、親会社株主に帰属する当期純損失は1,105,888千円となりました。また、営業キャッシュ・フローは、662,304千円のマイナスとなりました。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末における流動資産は1,171,393千円となり、前連結会計年度末に比べ777,683千円の減少となりました。これは主に現金及び預金が270,962千円減少、また仕掛品が215,849千円減少、原材料及び貯蔵品が208,889千円減少したことによるものです。

固定資産は23,908千円となり、前連結会計年度末に比べ680千円の減少となりました。これは主に投資その他の資産が680千円減少したことによるものです。

(負債)

当連結会計年度末における流動負債は376,632千円となり、前連結会計年度末に比べ211,800千円の増加となりま

した。これは主に短期借入金が100,000千円増加、買掛金が88,448千円増加、未払金が38,694千円増加したことによるものです。

固定負債は118,740千円となり、前連結会計年度末に比べ24,911千円の減少となりました。これは主に長期借入金返済により32,064千円減少したことによるものです。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は699,928千円となり、前連結会計年度末に比べ965,254千円の減少となりました。これは、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金が各々47,225千円増加したものの、親会社株主に帰属する当期純損失により利益剰余金が1,105,888千円減少したことによるものです。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は90,703千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は662,304千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が1,103,409千円となったこと、棚卸資産が336,552千円減少したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は1,906千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,906千円あったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果増加した資金は171,221千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が32,064千円あったものの、短期借入による収入が100,000千円あったこと及び新株予約権の行使による株式の発行による収入が94,451千円あったことによるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期	2024年12月期
自己資本比率 (%)	88.3	83.4	70.6	83.9	57.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	378.2	329.3	235.1	203.4	414.7
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	—	—	—	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	—	—	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

3. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

4. 2020年12月期、2021年12月期、2022年12月期、2023年12月期及び2024年12月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(4) 今後の見通し

(1) 当期の経営成績の概況で記載いたしましたとおり、半導体業界及び半導体検査装置業界は、需要が拡大しつつあります。しかしながら、2024年の実績を鑑みますと、市場の動向及び顧客の新規設備投資の予測を、現時点で正確に見定めることは非常に困難であると判断いたしました。通期の業績見通しにつきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示することとさせていただきます。

①主たる既存事業への取り組み

ア. 検査装置機能の高速化及び機能性向上

当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、高度化・多様化するお客様の検査ニーズにお応えするため、既存検査技術の革新を進め、お客様における設備投資機運が低迷するなか次世代半導体向け高機能検査装置

（WTS-9000、WTS-577SX）の開発を完了させることができ、2024年12月開催のセミコン2024で販売開始のご案内をさせて頂きました。また開発段階で販売を加速させるため、WTS-9000を大幅に小型化し、お客様の半導体開発部門向けに小型化しデスク下に置くWTS-588Dを同時にリリースし、2025年のマーケットに打って出る準備を整えました。

さらに足元の計画として、製造能力の強化、品質管理体制の整備推進を実施し、また、お客様にとってより信頼される企業として成長するために、以下の取り組みを進めております。

当社の主たる事業分野である半導体検査装置事業分野、特にディスプレイ・ドライバICは、スマートフォンに代表されるように新製品サイクルが非常に早く、おおよそ、6か月を目途として新製品がリリースされ、その技術レベルや機能のレベルが上がるごとに新機能を実現するための「新開発半導体チップ」が要求され開発されています。そのため、当社グループとして、量産向けだけではなく、上述のようにWTS-588D開発部門向け検査装置をリリースし、WTS-9000と操作環境、プログラム環境を同一とし、開発からデバイスチップの量産までをシームレスに繋がられるようお客様に提案できることといたしました。加えて応用技術部門では、市場要求（新開発半導体チップ）に合わせた新機能を検査する手法の開発と多角的な検査のアプローチ方法を提案、ベンチマークを行い、より検査の幅を厚くする取り組みを続けてまいります。

イ. 営業力強化・顧客サポートの充実

半導体検査装置においては高精度、低コスト、高速化に加え信頼性の向上が求められるだけでなく、更に使いやすいユーザーインターフェースと、検査用プログラミング補助機能の強化などを実現する必要があります。それぞれをこれまでにないスピードで推し進めることが、同分野において求められることから、組織と業務運営体制の整備を進め、よりスピーディーな開発判断ができるように組織改革、横浜、大阪における事業所再編を行ってまいります。

また子会社である、ウインテスト武漢においては、次世代型検査装置の製造を早期に移管、製造規模の拡大を計画します。また、開発能力を生かし、従来機を中心に新機能や高速化を目的とした開発や改良を行い、製造品質の強化に努め、販売においては蘇州にサポートと販売拠点を設けておりサポート、営業の強化を進めてまいります。

②新規事業による事業の多角化への取り組み

当社は、業務範囲の拡充を目的に、産学連携を行っております。以下に産学連携の進捗につきご説明申し上げます。

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）、当該技術については、慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、積極的に特許申請を進めており、今までに取得した特許に加え新規の特許申請手続きに入っています。現在、同技術を民生「物流搬送市場」におけるトラック向け昇降補助装置（テールゲートリフター）として製品化を進めており、製品化に向け設計専門会社へ委託、製造会社とも協議を進め2025年中には小型トラック、ワンボックスバン、軽貨物向け製品を販売する計画です。販売に当たっては、物流関連の協会などを通し、大手物流企業と連携し拡販を図ってまいります。物流市場は、サーチラボ社によると、物流業界に激震が走った2024年問題を皮切りに、人手不足・荷役作業による怪我を防止する意味でも安価なテールゲートリフターが求められているとのことです。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG、ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、現在特定のお客様への試験販売を行っていましたが、基礎データの収集も一段落したことから、共同事業提携先となる株式会社TAOS研究所を中心に奈良県立大学とアライアンスを継続、この度、製造における技術課題に目処も立ったことから製品化を行い、2025年早期に一般への販売を計画いたします。なお、販売にあたっては大手介護事業者並びに大手衛生機器関連会社等と連携し、進めて行く計画です。

水素ナノパブルイオン洗浄水に関しましては、今後内製化を行い洗浄用途だけでなく環境改善など幅広い用途に使えることが判明いたしました。小規模BtoB又はBtoC向けとしては、装置単体の販売を計画し、また大規模顧客向けには、装置のレンタルを含め提供してまいります。

そのほかでは、当社のCMOSイメージセンサー検査装置技術を生かし、業界一の低価格で提供できるX線による3D断層画像診断装置WTS-CT130を大学等の研究機関等を中心として販売してまいります。

（注）インダストリー4.0 検査装置向け工場FA化機器技術に使われる「自重補償機構技術」とは

一般的な「重量物搬送装置」は、電気モーターやエンジン等の動力源を持ち、かつ、重いカウンターウェイトや油圧・圧縮空気の出力を借りることで、数十キロから数百キロの重量物の移動をアシストしますが、装置が大掛りで重量が重くなることや、重量物に見合う外部動力が必要となるといった課題を有しています。これらの課題克服のため、当社と慶應義塾先端科学技術研究センターは、いかなる動力や重いカウンターウェイト、そして油圧・空圧機器をも使用しない「自重補償機構」の開発を進め、バネの弾性力を応用した軽量かつシンプルな構造を内蔵したロボットアームの継続開発を行っております。今般開発した試作機は、被搬送物の重量が変化した場合でもその重さに見合った自重補償ができる構造となっており、回転軸を除く各軸にて搬送する重量物の自重補償を達成し、

自身の腕部分の自重をも含め、より安全な自重補償を成立させています。

（5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、「株主に対する利益還元」を経営課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主利益向上に努めるとともに、配当につきましても、業績に応じ安定的な配当の継続を行うことを基本方針としております。しかしながら、企業体質の強化や競争力の維持及び今後の事業展開を行うには安定的な資金確保が必要となります。そのため、内部留保に重点を置いた方針を実施することもあります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に技術やコスト競争力を高め、市場ニーズに応える製品の開発体制を強化し、また、営業分野における海外での活動を展開するための原資として備えたいと考えております。

なお、当社グループは期末配当に加え、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に規定し、年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当連結会計年度の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、誠に遺憾ながら引続き無配とさせていただきます。

（6）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、半導体市場の減速の影響により、前連結会計年度における売上高は407,449千円となり、営業損失558,459千円、親会社株主に帰属する当期純損失554,572千円を計上いたしました。なお、営業キャッシュ・フローは、558,267千円のマイナスとなりました。

当連結会計年度（2024年1月～12月）における世界半導体市場は、WSTS（World Semiconductor Trade Statistics／世界半導体市場統計）の発表によると、2024年は前年比+16.0%増の6,112億ドル（約95兆円）になるとの見通しでした。AI関連投資が好調で、これに伴ってメモリー製品やAIで使用されるGPUなどの複合ロジック製品半導体が市場の牽引役となりました。一方AI関連を除くと、自動車用途が低迷したほか、設備投資の冷え込みを背景とした産業用途の不振、また民生向け半導体など全方位に亘り多くの製品で前年比マイナス成長となりました。2023年の半導体ダブつき解消後の「復活の年」という意味でも大きく期待された2024年の新規設備投資は、半導体工場各社の稼働率低迷継続をうけ、新規設備投資の抑制が年度末まで続く事態となりました（2025年1月6日付ストックマーク社記事「2024年の半導体市場は「復活の年」だったのか？」より引用）。そのため、当社グループの2024年度の受注、売上は低調に推移いたしました。

以上より、当連結会計年度の売上高は、417,090千円と前期より増加し回復基調にあるものの、営業損失は1,083,829千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を1,070,218千円計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、662,304千円のマイナスとなりました。

上述のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「3. 連結財務諸表及び主な注記（5）連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）」に記載しております。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	361,665	90,703
受取手形	—	291
売掛金	106,452	88,595
電子記録債権	2,433	—
商品及び製品	118,278	33,534
仕掛品	813,622	597,773
原材料及び貯蔵品	525,733	316,844
前渡金	4,094	2,618
未収消費税等	5,561	26,620
その他	11,234	14,410
流動資産合計	1,949,076	1,171,393
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物（純額）	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具（純額）	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品（純額）	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	24,588	23,908
投資その他の資産合計	24,588	23,908
固定資産合計	24,588	23,908
資産合計	1,973,665	1,195,301

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	12,077	100,526
短期借入金	—	100,000
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
未払金	52,286	90,980
未払法人税等	13,959	2,476
契約負債	3,303	28,023
製品保証引当金	552	—
その他	50,587	22,560
流動負債合計	164,831	376,632
固定負債		
長期借入金	136,966	104,902
リース債務	171	7,228
資産除去債務	6,513	6,609
固定負債合計	143,651	118,740
負債合計	308,482	495,372
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,627,193	1,674,419
資本剰余金	1,913,679	1,960,905
利益剰余金	△2,023,127	△3,129,016
株主資本合計	1,517,745	506,308
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	138,203	174,782
その他の包括利益累計額合計	138,203	174,782
新株予約権	9,234	18,837
純資産合計	1,665,183	699,928
負債純資産合計	1,973,665	1,195,301

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
売上高	407,449	417,090
売上原価	256,025	※ ₁ 755,927
売上総利益	151,423	△338,837
販売費及び一般管理費	709,883	※ ₂ , ※ ₃ 744,992
営業損失(△)	△558,459	△1,083,829
営業外収益		
受取利息	59	237
為替差益	13,271	—
その他	1,283	1,920
営業外収益合計	14,614	2,157
営業外費用		
支払利息	5,435	11,450
支払手数料	2,112	680
その他	702	277
営業外費用合計	8,250	12,408
経常損失(△)	△552,095	△1,094,080
特別損失		
減損損失	—	9,328
特別損失合計	—	9,328
税金等調整前当期純損失(△)	△552,095	△1,103,409
法人税、住民税及び事業税	2,476	2,478
法人税等合計	2,476	2,478
当期純損失(△)	△554,572	△1,105,888
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△554,572	△1,105,888

（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）	当連結会計年度 （自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）
当期純損失（△）	△554,572	△1,105,888
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	34,044	36,579
その他の包括利益合計	34,044	36,579
包括利益	△520,528	△1,069,309
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	△520,528	△1,069,309
非支配株主に係る包括利益	—	—

（3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,210,563	1,497,050	△1,468,555	1,239,059
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△554,572	△554,572
新株の発行	416,629	416,629		833,259
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	416,629	416,629	△554,572	278,686
当期末残高	1,627,193	1,913,679	△2,023,127	1,517,745

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	104,158	104,158	9,500	1,352,717
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）				△554,572
新株の発行				833,259
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	34,044	34,044	△266	33,778
当期変動額合計	34,044	34,044	△266	312,465
当期末残高	138,203	138,203	9,234	1,665,183

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,627,193	1,913,679	△2,023,127	1,517,745
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△1,105,888	△1,105,888
新株の発行	47,225	47,225		94,451
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	47,225	47,225	△1,105,888	△1,011,436
当期末残高	1,674,419	1,960,905	△3,129,016	506,308

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	138,203	138,203	9,234	1,665,183
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）				△1,105,888
新株の発行				94,451
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	36,579	36,579	9,603	46,182
当期変動額合計	36,579	36,579	9,603	△965,254
当期末残高	174,782	174,782	18,837	699,928

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）	当連結会計年度 （自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純損失（△）	△552,095	△1,103,409
減価償却費	—	428
減損損失	—	9,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,884	—
製品保証引当金の増減額（△は減少）	252	△552
受取利息及び受取配当金	△59	△237
支払利息	5,435	11,450
為替差損益（△は益）	0	—
売上債権の増減額（△は増加）	△66,162	20,463
棚卸資産の増減額（△は増加）	115,245	336,552
前渡金の増減額（△は増加）	4,658	1,483
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,919	81,418
未払又は未収消費税等の増減額	7,709	△21,058
その他	△45,594	15,524
小計	△550,414	△648,608
利息及び配当金の受取額	59	237
利息の支払額	△5,435	△11,450
法人税等の支払額	△2,477	△2,483
法人税等の還付額	0	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△558,267	△662,304
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	—	△1,906
無形固定資産の取得による支出	△300	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△300	△1,906
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	△159,998	100,000
長期借入金の返済による支出	△32,064	△32,064
リース債務の返済による支出	△171	△769
新株予約権の発行による収入	4,914	9,603
新株予約権の行使による株式の発行による収入	428,424	94,451
株式の発行による収入	399,921	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	641,025	171,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	727	222,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	83,185	△270,962
現金及び現金同等物の期首残高	278,480	361,665
現金及び現金同等物の期末残高	361,665	90,703

（5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、半導体市場の減速の影響により、前連結会計年度における売上高は407,449千円となり、営業損失558,459千円、親会社株主に帰属する当期純損失554,572千円を計上いたしました。なお、営業キャッシュ・フローは、558,267千円のマイナスとなりました。

当連結会計年度（2024年1月～12月）における世界半導体市場は、WSTS（World Semiconductor Trade Statistics／世界半導体市場統計）の発表によると、前年比+16.0%増の6,112億ドル（約95兆円）になるとの見通しでした。AI関連投資が好調で、これに伴ってメモリー製品やAIで使用されるGPUなどの複合ロジック製品半導体が市場の牽引役となりました。一方、AI関連を除くと、自動車用途が低迷したほか、設備投資の冷え込みを背景とした産業用途の不振、また民生向け半導体など全方位に亘り多くの製品で前年比マイナス成長となりました。2023年の半導体ダブつき解消後の「復活の年」という意味でも大きく期待された2024年の新規設備投資は、半導体工場各社の稼働率低迷継続をうけ、新規設備投資の抑制が年度末まで続く事態となりました（2025年1月6日付ストックマーク社記事「2024年の半導体市場は「復活の年」だったのか？」より引用）。そのため、当社グループの2024年度の受注、売上は低調に推移いたしました。

また、当社は、当社グループが保有する棚卸資産について厳格な評価を実施し、連結において574,470千円の棚卸資産評価損（売上原価）を計上いたしました。

近年、業界全体において市場環境が変化しており、特に受注の伸び悩みが見られる状況が続いています。当社におきましても、一部製品の市場動向を慎重に精査した結果、保有する棚卸資産の一部について、将来的な回収可能性について精度を高めて評価する必要があると判断しました。これに伴い、監査法人とも協議のうえ、適正な会計処理を行うために棚卸資産の評価損を計上することといたしました。

これは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）に従い資産評価の健全性を確保するために実施するものであります。今回の評価損計上により、短期的な財務指標には影響が出るものの、これは将来的な財務の健全性を確保し、持続的な成長基盤を強化するための戦略的な判断であります。当社は今後も、事業構造の見直しや市場ニーズに適した製品戦略を推進し、収益性の向上を図る施策を進めてまいります。また、当該棚卸資産に関しましては、2025年以降出荷される製品にすべて組み込む予定です。

当社の当連結会計年度の売上高は417,090千円となり、営業損失は1,083,829千円、経常損失は1,094,080千円、親会社株主に帰属する当期純損失は1,105,888千円となりました。また、営業キャッシュ・フローは、662,304千円のマイナスとなりました。

上記のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

前述のとおり、AI市場以外の民生市場及び産業向け半導体市場は2024年度の新規設備投資を控えており、新設された各顧客における新工場など竣工はしたものの、設備導入は2025年度予算に組入れる様子です。しかし、今後の半導体市場は、各国政府の進めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のさらなる進展や脱炭素化推進に向けた取り組み、自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しいイノベーションが期待されており、今後はAI関連だけではなくAIを基盤としたサービスのアウトプットに対応する半導体を含め、新しい技術が急速に開発・開拓され、広範な需要に支えられ伸長するものと想定されております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、液晶パネルに使われるLCDドライバICの検査に使用されており、また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も大きな伸びが期待される分野です。当社の主力検査装置WTS-577SRは主にローエンドデバイス向けとし、2024年12月に開催されたセミコンジャパン2024展示会で完成リリースを行ったWTS-577SXにつきましては、ミドルクラスからハイエンドデバイス向けとし、新たに同展示会でリリースを行ったWTS-9000フラッグシップ機をハイエンド超多数個の同時測定用として販売しております。また、セミコンジャパン2024展示会では、国内外から多くのお客様にご来場いただき、実機展示を行っているメーカーが少ないこともあって国外、国内の御来場者から大きな反響を頂きました。その結果、WTS-9000においては、2025年1月20日に「次世代ディスプレイ・ドライバーIC検査装置WTS-9000受注及び初出荷のお知らせ」にてお知らせいたしましたように、リリース直後に海外のお客様から受注を頂くことができました。また、国内顧客からは、汎用ロジック検査装置WTS-3000のお引合いを多く頂くことができました。これら検査装置の受注は、設備投資が再開されると期待される2025年第2四半期（多くの日本のお客様では第1四半期）以降を予定しております。

今後、ウインテスト武漢との協力体制強化を土台にし、中国PMI社並びに台湾代理店との協力関係を推し進

め、営業活動を見直してまいります。さらに、ウインテスト武漢においては、顧客対応力の強化を目的にエンジニアの採用を促進、更なるサポート体制の強化と製造においては品質の向上に取り組み、今後AI市場の活性化が著しい中国国内市場への深耕を図ってまいります。

2. 技術開発の強化

当社は、これまでのICチップの検査装置に加え、新たに2025年1月28日に「ウエハ・アクセプタンス・テスト(WAT)検査装置「WTS-511」リリース、販売開始のお知らせ」で開示いたしましたように、新領域である半導体製造工場で行う電氣的検査で、設計基準や顧客要求を満たしているか出荷される前の最終的な品質保証プロセスを検証できる検査装置を市場に投入してまいります。また汎用ロジックIC検査装置（256チャンネル、512チャンネル、1024チャンネル、周波数400Mhz）に関しては、国内、台湾、中国顧客向けを想定したWTS-3000、WTS-677そしてWTS577Lとして販売を開始しております。またロジック検査装置、ディスプレイ・ドライバ検査装置に関しましては、先端機能を更に引き上げるべく引続き開発を継続しております。これによって、ローエンド市場からハイエンド市場までを網羅的にカバーできる装置ラインナップを揃えました。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、2025年までに当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用しつつ、外部専門会社からの協力のもと、今後の市場拡大が見込まれる5Gと、その後の6G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

3. 隣接領域の展開と製品化

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）、当該技術については、慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については完了し、また現在は2024年中に開発した新技術について新たに特許の申請手続きに入っております。当初当社検査装置関連で製品化を目指しておりましたが、2024年に方向を転換、2024年問題で揺れる「物流輸送市場」における手動リフトゲートトラック向け補助装置の製品化を行っており、現在はロボットの開発設計製造の得意な工場に委託を行っており、2025年6月にプロトタイプ制作、複数のコンサル会社のアドバイスをもとに2025年中には量産体制を整え販売を開始いたします。なお、コンサル・アドバイザーとしてジェイ・フェニックス・リサーチ社と契約を結んでおります。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し、量産方法の試行錯誤を完了し量産に向け当社大阪事業所並びにご協力企業様と協議を進めており、2025年4月からの本格販売に向け計画を進めております。販売に関しましては株式会社TAOS研究所主導のもと、強いご興味を頂いているウエルコンサル株式会社（大阪市生野区）などと連携し進める方向です。またコンサルには同じくジェイ・フェニックス・リサーチ社と契約を結び、販売チャンネルの多角化などを協議しております。

水素ナノバブル・アルカリイオン・洗浄水に関しましては、各種の実験を通し概ね良好な結果が得られましたことから、現在イオン水生成装置の内製化に取り組んでおり、イオン水を試験的にご希望の企業様に実験用として無償で供給させて頂いております。今後、本格販売に向け生成装置の内製化を加速してまいります。

（注）インダストリー4.0 検査装置向け工場FA化機器技術に使われる「自重補償機構技術」とは

一般的な「重量物搬送装置」は、電気モーターやエンジン等の動力源を持ち、かつ、重いカウンターウェイトや油圧・圧縮空気の出力を借りることで、数十キロから数百キロの重量物の移動をアシストしますが、装置が大掛りで重量が重くなることや、重量物に見合う外部動力が必要となるといった課題を有しています。これらの課題克服のため、当社と慶應義塾先端科学技術研究センターは、いかなる動力や重いカウンターウェイト、そして油圧・空圧機器をも使用しない「自重補償機構」の開発を進め、バネの弾性力を応用した軽量かつシンプルな構造を内蔵したロボットアームの継続開発を行っております。今般開発した試作機は、被搬送物の重量が変化した場合でもその重さに見合った自重補償ができる構造となっており、回転軸を除く各軸にて搬送する重量物の自重補償を達成し、自身の腕部分の自重をも含め、より安全な自重補償を成立させています。

財務施策

財務面については、財務基盤の安定化を図るために、2024年9月15日開催の取締役会において、GFA株式会社を割当先とする1,000万株の第三者割当による新株予約権の発行を決議し、2024年12月31日時点までに新株予約権の一部行使によって92,820千円の資金調達を実施しました。これにより、今後の半導体検査装置事業に必要なリニア半導体など新領域並びに新規事業の展開資金を確保するとともに、併せて財務基盤の強化を図りました。しかし、上述でご説明いたしましたお客様工場における新規設備投資が2024年中には回復せず、2025年にずれ込

むなど、想定より長期にわたることから、業績の低迷が続き、加えて2021年～2023年にかけて発生した検査装置に不可欠な産業用半導体部品の大幅な不足と納期遅延、価格高騰を受け、タイムリーな製造ができるように早期の部材仕入れを行った結果、運転資金となる現預金が計画より減少することとなりました。今後とも筆頭株主である武漢精測と諮りながら、同社及び金融機関からの資金調達の施策を継続して実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でおりますが、2023年から2024年度中にまで引き続いた、半導体市場の生産調整などから、設備投資の大幅な抑制という事態になり、当社がメイン市場とする海外受注並びに受注済み検査装置の出荷・売上は、新規設備投資の再開される2025年度以降となります。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、前記の新株予約権による調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

1. 当該会計上の見積りの変更の内容

当社が保有する棚卸資産は、従来、営業循環過程にあるかどうかを区別し、営業循環過程にあるものは毎年販売予定額等により簿価切下げを行い適正在庫を超える余剰分を余剰在庫として25%減価し、営業循環過程にないものは毎年帳簿価額の30%の簿価切下げを行ってまいりました。

しかし、近年当社が置かれている状況を鑑み、長期滞留している棚卸資産は販売予定額を見定めることが困難であり、また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）に従い資産評価の健全性を確保する見地から、営業循環過程にある棚卸資産に関しましても、耐用年数を定め、定額により簿価切下げを行うことといたしました。

2. 当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額

1. の会計上の見積りの変更により、従来の方法と比べて当連結会計年度の売上原価が509,110千円増加し、従来の方法と合計して574,470千円を売上原価に計上することとなり、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失が同額増加しております。

3. 当該会計上の見積りの変更は当連結会計年度の翌連結会計年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。当該影響額は、影響額を合理的に見積ることが困難であります。

（連結損益計算書に関する注記）

※1 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
棚卸資産帳簿価額切下額	63,687千円	574,470千円

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
役員報酬	42,300千円	40,132千円
給料及び手当	171,391	179,340
研究開発費	232,957	227,262

※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
	232,957千円	227,262千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	その他	合計
239,604	133,622	34,221	407,449

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日清紡マイクロデバイス株式会社	78,000	半導体検査装置事業
沖エンジニアリング株式会社	58,510	半導体検査装置事業
蔚華電子科技(上海)有限公司	56,521	半導体検査装置事業
合肥宏芯達微电子有限公司	50,837	半導体検査装置事業

当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	インドネシア	合計
110,355	262,657	44,077	417,090

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
合肥宏芯達微電子有限公司	142,160	半導体検査装置事業
上海精積微半導体技術有限公司	84,860	半導体検査装置事業
PT. EPSON BATAM	44,077	半導体検査装置事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1株当たり純資産額	37円94銭	15円12銭
1株当たり当期純損失（△）	△13円85銭	△25円27銭

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
純資産の部の合計額（千円）	1,665,183	699,928
純資産の部の合計額から控除する金額（千円）	9,234	18,837
（うち新株予約権（千円））	(9,234)	(18,837)
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	1,656,949	681,091
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株）	43,641,000	45,059,100

3. 1株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1株当たり当期純損失（△）		
親会社株主に帰属する当期純損失（△） （千円）	△554,572	△1,105,888
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△） （千円）	△554,572	△1,105,888
普通株式の期中平均株式数（株）	40,029,819	43,761,441
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 243,000個 （普通株式 243,000株）	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 236,000個 （普通株式 236,000株）

（重要な後発事象）

新株予約権の行使

当連結会計年度後、当社が2024年10月31日に発行した第12回新株予約権（行使価格修正条項付）の権利行使が行われております。

新株予約権が行使され、2025年1月1日から2025年2月13日までに発行した株式の概要は以下のとおりであります。

- (i)行使された新株予約権の個数：73,180個
- (ii)発行した株式の種類及び株式：7,318,000株
- (iii)資本金増加額：289,384千円
- (iv)資本準備金増加額：289,384千円

以上より、発行済株式総数は7,318,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ289,384千円増加し、2025年2月13日現在の発行済株式総数は52,377,100株、資本金は1,963,804千円、資本準備金は1,963,804千円となっております。